

## 2-1-2-21 SR 表面糊状異物付着／SR 表面附着粘性杂物／Pasty foreign object on solder resist surface

【特徴】SR 表面に糊や粘土状の異物が付着している状態の欠陥

【特征】SR 表面附着胶或者粘性杂物的缺陷

【Characteristics】A pasty or clay-like foreign object is adhered on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面に糊状または粘土状の異物が付着して出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 表面附着胶或者粘性杂物而造成的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by a pasty or clay-like foreign object adhered on the solder resist surface. (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×

## 2-1-2-22 SR 面テープ残り／SR 表面附着胶带屑／Tape left on solder resist surface

【特徴】識別マークテープやラベル、セロテープなどがSR 表面に付着したままになっている状態の欠陥

【特征】在SR 表面附着识别胶带、标签、透明胶带等屑的缺陷。

【Characteristics】An identification mark tape, a label, cellulose tape or the like is left attached on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】識別マークテープやラベル、セロテープ等の屑が誤って転写付着したり、除去忘れや除去残りなどにより出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】错误地让识别胶带、标签、透明胶带等的屑转移，或者忘记擦掉、擦不干净而造成的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A debris of an identification mark tape, a label, cellulose tape or the like is transferred and attached to by mistake, and left unremoved or incompletely removed on the solder resist surface. (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】セロテープ残り  
顕微鏡倍率×33

【注釋】透明胶带屑  
显微镜倍率 ×33

【Comments】Cellulose tape left unremoved  
Magnification: ×33